

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

上海富瀚微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	吴文吉 万玮 应明哲 邵子豪 王斌	中邮证券 中邮证券 国金证券 易方达基金管理有限公司 摩根士丹利基金管理有限公司
时间	2026年3月11日	
地点	公司会议室（电话会议）	
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书万建军先生； 投资者关系总监吴斯文先生；	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、Q&A 环节</p> <p>Q:近期公司股东减持的主体、原因及对公司控制权的影响如何？</p> <p>A:减持主体为杰智控股，其属于一致行动人但并非控股股东或实际控制人本人，公司实控人及核心一致行动人如陈春梅、龚传军在报告期内未发生减持。杰智控股减持是因作为 PE 基金需到期退出清算，并非基于看衰公司。同时减持规模可控，即便按照顶格减持计算，实控人及一致行动人合计持股仍超过 20%，控制权稳定性不受影响，对公司价值基本不产生影响。</p>	

Q:对未来业绩的展望及趋势判断是怎样的？

A:公司判断去年年中为这一轮周期的底部，自 25 年二季度起销售逐步向上。从目前在手订单及客户预期来看，后续总体呈现供不应求状态。公司今年给销售部下达任务也比较高，期待实现销售的大幅增长。

Q:公司对未来一两年业绩的判断及底层逻辑是什么？

A:公司对未来一两年业绩持非常乐观的态势，底层逻辑包括：一是存储器涨价会带动产品售价向下传递；二是公司近年持续投入新产品，2026 年将有多多个有竞争力的新产品上市并形成量产，对今年业绩做出贡献。

Q:存储涨价是否影响下游需求？不同领域的影响有何差异？

A:目前存储涨价尚未反映到客户的预测中，客户订单预期给得较足，一方面是客户担心涨价处于抢货状态，另一方面客户也已向下游发布涨价通知，反馈形势还好；若进一步涨价是否导致需求萎缩暂难判断。消费类可参照手机，或有可能影响消费者购买决策；工业类和汽车类受影响较小。

Q:公司芯片中使用的存储规格、价格变化及成本占比情况如何？

A:公司芯片使用的存储为 KGD（裸片形式与芯片合并），规格包括 DDR（DDR2、DDR3 为主，容量 16-256M）和 PSRAM（目前有 32-64M 大容量、高速产品，性能接近 DDR2）。

DDR2 因上游产能退出（供应商转向 DDR4、DDR5）供应紧张；DDR2 价格较去年上半年涨了好几倍，因此存储成本占比从原来的 20%-40%升至 60%-70%甚至更高；同时目前 PSRAM 技术进步快，未来可能成为 DDR2 供应紧张时的替代。

Q:公司能否拿到与需求匹配的 DDR2、DDR3 产能？

A:目前存储供应链是公司工作重中之重，行业处于抢产能状态，客户存在恐慌性备货，若全部接下恐慌性备货的订单可能无法完全满足，但目前能保证客户正常生产需求的供应量。

Q:存储价格翻五倍后，下游客户是否接受公司产品提价？

A:目前客户更关注保障供应量，价格随行就市即可。

Q:公司 2026 年新产品的的主要应用领域和产品类型有哪些？

A:2026 年公司新产品包括：1. AI ISP 芯片：去年推出，经半年研发后客户已发布，市场反响良好，今年将实现较大的量增长，前期主要应用于智能安监领域（含专业和消费类），应用于 GoPro 或影石这类便携式运动相机应用的 SoC 在开发中；2. 边缘侧芯片：客户预计 3-6 月逐步发布多款机型，应用场景包括专业的 DVR、NVR，以及消费类的 NAS、家庭网关等；3. AIoT 芯片：应用于智能门铃、智能显示、智能电动车等场景；4. 车载芯片：今年开发了一批德系著名高端品牌及部分新势力等新客户，电子后视镜等新产品成

为整车厂产品的新卖点，市场反馈良好。

Q:AI ISP 芯片的具体应用场景和功能特点是什么？

A:AI ISP 芯片前期主要应用于智能安防领域（含专业和消费类），其核心功能为“黑光”技术——在全黑环境下仍能清晰呈现物体并还原色彩；用于运动相机等的穿戴类 SoC 芯片目前还在开发中。

Q:边缘侧芯片的具体应用场景有哪些？

A:边缘侧芯片的应用场景包括专业领域的 DVR、NVR（需集成算力），以及消费类领域的 NAS、家庭网关等。

Q:2026 年智能安防行业的复苏情况及下游客户库存现状如何？

A:下游客户库存经过 2025 年上半年去库存后，已降至近 3~5 年以来的低点，在当前存储紧张的情势下，目前正逐步回补库存。

Q:专业视频业务的订单能见度如何？

A:专业视频业务订单模式为“1+5”：客户下下个月的订单，同时提供未来五个月（半年）的 forecast。

Q:端侧 AI 产品的算力迭代节奏、量产及客户导入时间表是怎样的？

A:端侧 AI 产品的进展如下：1. 量最大的芯片预计 3 月发布，算力相对较低；2. 5T 算力芯片客户已开发，预计 Q2 量产，主要应用于 XVR（支持文搜大模型类产品）、高端 AI 功能前端摄像机、NAS；3. 更大算力芯片（8-10T）预计 Q3 流片。

Q:公司在 AI 眼镜领域的产品进展如何？

A:公司已有一款 AI 眼镜产品，今年部分客户将陆续实现量产；下一款 AI 眼镜产品预计 8 月推出。

Q:车载 ISP 及 MIPI 在前装整体量产的进度如何？今年在前端有哪些进展？

A:车载业务进展较大：客户方面，已进入大多数新势力，且德系豪华品牌客户也已突破；产品方面，800 万像素 CMS（电子后视镜）方案为市面上规格最好，已成为某些国内著名品牌高端车型的卖点，获市场认可；MIPI-Aphy 芯片已上车，搭载于某新车型，目前反馈不错，期待后续大规模升级换代。

Q:2026 年公司三大业务的发展展望及收入占比规划是怎样的？

A:2025 年因上半年客户控库存，专业视频业务占比下降，另外两块业务占比上升；2026

年预计客户去库存完成叠加涨价因素，专业视频业务因基数低增速有望可观回升，达成较高增速，智慧物联业务增速良好，整体目标为销售额创历史新高。

Q:2026 年公司盈利能力与 2021 年相比会怎样？

A:2021 年利润水平较高，2026 年利润保持 2022 年高点有难度但会争取；因存储涨价幅度较大，若维持原高毛利，市场接受度不确定，与 2021 年情况有所不同。

Q:下游客户是否存在自行采购存储原料并提供给公司、仅支付加工费的模式？

A:目前行业内暂无该模式案例。

Q:公司投资魔芯的后续合作及产品落地情况如何？

A:投资魔芯主要基于战略方向前瞻性布局、团队技术实力及合作基础（已与 Meta、中国电信等展开合作）。双方团队有较强协作意愿，目前正深度讨论产品协作方向，进展将后续汇报。魔芯的世界模型系列算法可助力 AI/机器像人类一样理解物理世界，与机器人导航避障，数字孪生，自动驾驶等应用场景存在大量机会，未来有望形成协同。

Q:公司是否会对魔芯追加投资或纳入生态版图？

A:都有可能，届时视情况而定。因算法公司通常研发费用较高，增持并购动作需考虑对

	<p>上市公司整体财务报表的影响。</p> <p>Q:公司今年后续外延并购及产业投资聚焦的方向是什么？</p> <p>A:将持续关注 AI 领域，包括大模型、云端和端侧 AI 算力芯片及相关大芯片，有合适机会将进行资本布局；同时在产品横向扩展方面，对前期投资布局的多家公司，在合适时机或需助力时会持续资本投入。</p> <p>Q:公司在具身智能、端侧 AI 市场的卡位及壁垒情况如何？</p> <p>A:在机器人领域已与海康机器人合作，芯片已经量产；具身智能领域目前关注商业机会，今年将加大市场投入力度，目标是在优质客户中导入两三家产品方案。</p> <p>Q:上游晶圆成本目前有什么变化？</p> <p>A:晶圆成本方面，自 2021 年、2022 年上涨后，近几年公司拿到的价格逐步下行。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2026 年 3 月 11 日